



# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เพชรเป็นวัสดุที่มีสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่โดดเด่นกว่าวัสดุชนิดอื่น ทั้งทางเคมีและทางฟิสิกส์ อาทิเช่น มีความแข็งแกร่งสูง สภาพนำความร้อนที่อุณหภูมิห้องสูงที่สุด ค่าความร้อนจำเพาะและสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ เจือยต่อปฏิกิริยาเคมีและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี โปร่งแสงในช่วงกว้างตั้งแต่อัลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรดและมีดัชนีหักเหสูง เพชรมีช่องว่างแถบพลังงาน 5.47 eV ซึ่งค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับ ซิลิกอน (1.12 eV) และ เจอมาเนียม (0.66 eV) [1, 2] สมบัติต่างๆ ดังตารางที่ 1.1 ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 1.1 สมบัติต่างๆ ของเพชร [3, 4]

สมบัติของเพชร	ปริมาณ
ความหนาแน่น	$3.52 \text{ g cm}^{-3}$
สัมประสิทธิ์การเสียดทาน	0.03
ความแข็ง	$1 \times 10^4 \text{ Kg mm}^{-2}$
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความร้อน	$1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
สภาพความนำความร้อนที่อุณหภูมิห้อง	$2 \times 10^3 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
ความจุความร้อน	$6.2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
สภาพคล่องของอิเล็กตรอน	$2200 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
สภาพคล่องของโฮล	$1600 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
ช่องว่างพลังงาน	5.45 eV
สภาพต้านทาน	$10^{13} - 10^{16} \text{ } \Omega \text{ cm}$
ดัชนีหักเหที่ 591 nm	2.41

แต่เนื่องจากเพชรธรรมชาตินั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานหลายอย่าง ทั้งการมีอยู่อย่างจำกัด และมีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ จึงมีความพยายามที่จะสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงเพชรให้มากที่สุดขึ้น เพื่อนำเอาไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสมและลดต้นทุนการผลิต

ในปี ค.ศ. 1955 นักวิจัยบริษัทเยนเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric) [5] สังเคราะห์เพชรขึ้นในห้องปฏิบัติการได้สำเร็จ โดยจำลองภาวะการเกิดเพชรในธรรมชาติซึ่งเกิดภายใต้ภาวะความดันสูงและอุณหภูมิสูง (High Temperature High Pressure; HPHT) ด้วยการอัดแกรไฟต์ในเครื่องอัดไฮโดรลิก ที่ความดันในช่วง 50-100 kbar ความร้อนสูงถึง 1800-2300 K เพชรที่สังเคราะห์ได้เป็นเพชรผลึกเดี่ยวมีขนาดตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงระดับเซนติเมตร แต่เนื่องจากการต้นทุนในการผลิตเพชรจากวิธี HPHT ค่อนข้างสูงและอันตรายเพราะต้องผลิตที่ความดันสูงและอุณหภูมิสูง ในปี ค.ศ. 1971 Aisenberg และ Chabot [6] ทดลองยิงลำไอออนของคาร์บอน (C<sup>+</sup>) ลงบนแผ่นซิลิกอนภายใต้ความดัน 10<sup>6</sup> torr ฟิล์มที่ได้มีสมบัติใกล้เคียงกับเพชร อาทิเช่น โปร่งแสง ไม่นำไฟฟ้า ดัชนีหักเหสูงกว่า 2.0 ทนต่อการกัดกร่อนของกรดเป็นเวลานาน ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ระหว่าง 8-14 ซึ่งใกล้เคียงกับเพชร ด้วยสมบัติที่ใกล้เคียงกับเพชรเหล่านี้จึงเรียกฟิล์มชนิดใหม่นี้ว่า "ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร" (Diamond-Like Carbon; DLC) ภายหลังจากนั้นเทคนิคที่ใช้การสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ถูกพัฒนาขึ้นหลากหลายเทคนิค แต่ที่นิยมคือเทคนิคที่เรียกว่า การตกสะสมไอเชิงเคมี (Chemical Vapor Deposition; CVD) [7] ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดพลังงานที่ใช้กระตุ้นแก๊ส [8] เช่น ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับที่ความถี่คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ และได้ความร้อน (Hot filament; HF) เป็นต้น ฟิล์ม DLC มีข้อดีหลายประการ อาทิ สามารถสังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิต่ำทำให้สามารถสังเคราะห์บนวัสดุที่หลากหลายและมีการนำเอาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง [7] เช่น ระบายความร้อน (Heat sink) ในวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ เคลือบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่าน เคลือบเลนส์ เคลือบหน้าต่างของวัสดุทางแสงเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสง เคลือบอุปกรณ์ตัด จำพวก ใบเลื่อย มีดตัด และสว่าน ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

สุจิตรา พรหมนิมิต [9] ได้สร้างระบบกำเนิดพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ (Inductively coupled plasma: ICP) ขึ้นในห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมา ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้สังเคราะห์ฟิล์ม DLC จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าระบบที่สร้างขึ้นนี้สามารถกำเนิดพลาสมาที่ความดันต่ำได้ และฟิล์มที่สังเคราะห์ขึ้นมีลักษณะบ่งชี้ว่าเป็นฟิล์ม DLC แต่เนื่องจากยังคงมีปัญหาในระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ ที่ไม่สามารถจ่ายที่กำลังสูงได้ มีการปนเปื้อนจากของไอน้ำมันจากไอพีมไอฟุ้งกระจาย (Diffusion pump) และไม่มีตัวให้ความร้อนแก่

แผ่นรองรับ (Heater) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC การสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ที่อุณหภูมิประมาณ 400 °C [7,10] จะได้ฟิล์มที่มีคุณภาพดีกว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะแก่การสังเคราะห์ฟิล์ม DLC บนวัสดุจำพวกโลหะ หรือกระจก

ในงานวิจัยนี้จะปรับปรุงระบบ ICP ดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC และทำการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่วิทยุ (Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition; RF-PECVD) หรือเทคนิคอาร์เอฟ-พลาสมาพร้อมทั้งตรวจสอบสมบัติของพลาสมาในระบบด้วยหัววัดลางมัวร์ (Langmuir probe) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของพลาสมาและสมบัติของฟิล์ม DLC โดยวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (Scanning Electron Microscope; SEM) และวิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์มด้วยรามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy)

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ปรับปรุงระบบ RF-PECVD แบบ ICP ให้เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC
2. สังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD
3. ตรวจสอบภาวะการสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ได้

## 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบ RF-PECVD แบบ ICP ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ฟิล์มบาง DLC และทราบภาวะการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ที่มีต่อลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีของฟิล์ม ซึ่งลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีนี้จะเชื่อมโยงไปสู่สมบัติของฟิล์มที่สังเคราะห์ขึ้น

## 1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาการทำงานของเครื่องมือและขั้นตอนการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD
2. ปรับปรุงระบบ RF-PECVD แบบ ICP ให้เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC โดยการเพิ่มตัวให้ความร้อนแก่แผ่นรองรับและระบบระบายความร้อนเพื่อให้สามารถสังเคราะห์ฟิล์มที่อุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถ

สังเคราะห์ฟิล์มที่กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุสูงขึ้นและเพิ่มตัวกรองไอน้ำมันจาก  
ปั๊มไอฟุ้งกระจายเพื่อทำให้ระบบสะอาดขึ้น

3. สร้างหัววัดกลางมัวร์แบบชดเชยค่าภายในตัวเอง (Self compensate Langmuir probe) เพื่อใช้วัดพารามิเตอร์ของพลาสมาในระบบกำเนิดพลาสมาแบบ ICP ด้วยกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ
4. สังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD ภายใต้ภาวะการสังเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ อัตราส่วนของแก๊สตั้งต้น ความดันแก๊สและชนิดแผ่นรองรับ (Substrate) ซึ่งจะใช้กระจกและแผ่นอะลูมิเนียม
5. ตรวจสอบสมบัติของฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ได้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) และรามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy)
6. สรุปผลการวิจัย

#### 1.5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท รายละเอียดในแต่ละบทดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ วิธีดำเนินการวิจัย และลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย

บทที่ 2 กล่าวถึงโครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม DLC เทคนิค RF-PECVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ในงานวิจัยนี้ วิธีการวัดสมบัติของพลาสมา ซึ่งได้แก่ ความหนาแน่นของพลาสมาและอุณหภูมิอิเล็กตรอนด้วยหัววัดกลางมัวร์ วิธีการตรวจสอบสมบัติของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดและรามานสเปกโทรสโกปี

บทที่ 3 กล่าวถึงขั้นตอนการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาที่เกิดขึ้นในระบบ ส่วนที่ 2 เป็นการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD แล้วตรวจสอบสมบัติของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดและรามานสเปกโทรสโกปี

บทที่ 4 กล่าวถึงผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

บทที่ 5 จะเป็นการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ